

团 体 标 准

T/CEMIA 021—2019

厚膜集成电路用电阻浆料规范

Specification for resistance paste for thick film integrated circuits

2019-09-25 发布

2019-12-25 实施

中国电子材料行业协会 发 布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国电子材料行业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：西安宏星电子浆料科技股份有限公司。

本标准参与起草单位：中国电子科技集团公司第四十三研究所、陕西华经微电子股份有限公司、广东风华高新科技股份有限公司。

本标准主要起草人：鹿宁、赵莹、周宝荣、陆冬梅、孙社稷、王大林、崔国强、张建益、王璞、刘丝颖、梅元、赵科良、王耀东、董耀辉、李艳、李建辉、王伟、张登峰、任荣、王丽莎、杨晓平、莫雪琼。

厚膜集成电路用电阻浆料规范

1 范围

本标准规定了厚膜集成电路用电阻浆料的定义、技术要求、检验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于由功能相、玻璃相、有机载体以及添加剂组成,满足印刷特性的厚膜集成电路用电阻浆料(以下简称电阻浆料)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

SJ/T 11512—2015 集成电路用 电子浆料性能试验方法

3 术语和定义

3.1

方数 square number

浆料烧结膜图形的长/宽比值,单位符号用□表示。

4 技术要求

4.1 电阻浆料性能

电阻浆料性能应符合表 1 的规定。

表 1 电阻浆料性能

性能	细度/ μm	黏度/ $(\text{Pa} \cdot \text{s})^{\text{a}}$ (25 °C, 10 rpm)	固体含量/%
参数指标	$R_{\square} \leq 10 \ \Omega/\square; \leq 8$	100—200	≥ 60
	$R_{\square} > 10 \ \Omega/\square; \leq 5$		
^a 黏度范围内的具体数值由供需双方协商确定。			

4.2 电阻浆料烧成膜性能

电阻浆料烧成膜性能应符合表 2 的规定。